

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技

股票代码：688019

编号：2026-009

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>富国基金、国海富兰克林、国泰海通资管、华泰资产、交银施罗德、玖鹏资产、申万宏源、太保资产、太平基金、天风证券、伟星资产管理、西部利得基金、兴业基金、益和源资产管理、中银证券。</p>
<p>时间</p>	<p>2026 年 6 月 5 日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>公司 接待人员 姓名</p>	<p>职工董事、副总经理、董事会秘书 杨逊 资深总办投关专员 周婷婷</p>
<p>投资者关系 活动 主要内容介绍</p>	<p>一、公司介绍： 介绍公司经营业务及未来发展规划。</p> <p>二、问答环节主要内容： Q：公司 CMP 抛光液的增长势头很不错也很稳健，想了解未来增长的驱动力，以及外资供应商目前的市场情况是怎么样的？ A：未来增长的驱动力主要来自以下几个方面：一是随着公司产品在主要客户端的覆盖面和渗透度持续扩大，叠加客户产能爬坡及扩产计划，构成了我们增长的基础；“十五五”期间集成电路作为战略新兴产业的核心地位进一步凸显，为增长提供了有力的支撑。二是随着先进制程的不断演进，有越来越多新产品、新工艺、新应用的市场需求，公司持续加大研发投入，推动产品迭代与性能升级，以满足客户更高工艺节点的要求，凭借夯实的技术竞争优势，进一步巩固和扩大市场份额。三是国产化替代仍有空间，比如在国内外资背景的芯片制造公司中，外资供应商目前在其中仍占据一定份</p>

额，这也是我们持续努力获取市场份额的方向。以及公司在深耕并巩固国内市场的同时，稳健、有选择地探索海外市场机会，以实现海外业务的拓展。经过不断深耕，公司化学机械抛光液全球市占率近三年从 8%提升至 13%（根据 TECHCET 全球市场规模测算），已跻身全球主流供应厂商行列。未来，我们会持续专注、稳扎稳打地走更长的路。

Q：公司是否与三星、海力士、台积电等海外客户保持持续互动？

A：全球化是公司既定战略，自创立之初就以“立足中国、服务全球”为核心战略定位，公司已实现部分产品出海、部分产品进入国际客户供应链，我们秉持循序渐进、按需进展的策略，稳健、务实地推进海外业务发展。目前公司海外团队主要集中在中国台湾地区，团队规模持续壮大，能力维度不断拓展。已在积极对接中国台湾地区、东南亚等多家海外客户，业务涉及多个项目及产品，均有不同程度的进展，且符合预期。

Q：关注到原材料市场有涨价，对公司成本端及毛利率是否会有影响？

A：目前来看原材料价格波动的传导相对有限，成本端整体可控；目前毛利率的变动主要取决于产品结构的动态变化及处于不同生命周期的产品市场定位调整，具体以我们后续披露的定期报告为准。

Q：国内晶圆厂扩产节奏较快，公司产能规划是否能匹配客户需求？

A：公司每年都有固定资产投资在生产线上，产能逐步爬坡，可长期匹配客户现阶段及后续发展需求。现有基地方面，上海金桥、宁波北仑制造基地扩展有序推进，多条新增产线已投产；上海化学工业区电子化学品专区制造基地主体建筑已封顶，为下一阶段提供产能保障。同时公司通过优化空间布局、推进产线智能化改造，持续提升生产自动化与精细化水平。未来规划方面，公司秉持“小步快跑、滚动规划”的思路，以 3-5 年为周期研判行业发展，提前推进生产基地物理环境建设，持续跟踪市场发展，动态化灵活推进产线投资与产能爬坡，既保障稳定供货、承接新增需求，又避免盲目扩产导致资源闲置。

	<p>Q: 近期 CMP 行业竞争有所加剧，公司如何看待当前的竞争格局？</p> <p>A: 行业竞争是市场发展的规律，一个健康的市场也不可能只有一家公司，良性竞争有助于推动产业链整体进步。对安集而言，竞争更多是内在优化的动力，公司始终聚焦自身能力提升，依托深厚技术积累和快速迭代能力，深化客户合作，保持市场地位稳固。2025 年公司 CMP 抛光液全球市占率约 13%，已跻身全球主流供应厂商行列。客户对供应商的评估是综合的多维度的，会全面考量产品性能、技术能力、服务响应及合作稳定性，具备持续迭代能力且交付记录良好的供应商更易获得长期信赖。</p> <p>Q: 公司员工稳定性怎么样？</p> <p>A: 公司始终将员工视为企业最宝贵的财富，秉持“尊重、关怀、以人为本”的企业文化，通过完善的薪酬福利体系、职业发展通道及企业文化建设，持续提升员工归属感与稳定性。公司多年以来离职率低于行业水平，员工队伍整体稳定。公司设有管理序列、技术序列、专业序列等多元发展通道，并通过股权激励计划、学历提升支持等举措，让员工共享发展成果，实现个人成长与组织发展的协同并进。</p> <p>Q: 公司电镀液及添加剂业务的发展情况？</p> <p>A: 公司持续加强集成电路制造及先进封装领域的电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，产品覆盖应用于集成电路制造的大马士革工艺铜电镀液及添加剂、应用于先进封装领域的铜、镍、锡银等电镀液及添加剂以及硅通孔（TSV）电镀液及添加剂。目前，先进封装用电镀液及添加剂已有多款产品实现量产销售，应用于凸点、重布线层（RDL）、异质集成技术；集成电路制造领域的大马士革工艺铜电镀液及添加剂已进入量产阶段，实现销售，先进封装锡银电镀液及添加剂以及硅通孔电镀液及添加剂开发及验证按计划进行，公司将持续推进技术研发与市场拓展，逐步提升其市场份额与收入贡献。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 6 月 9 日